

---

## 未來計劃及[編纂]

---

### 未來計劃

有關我們的未來計劃的詳細說明，請參閱「業務 — 發展戰略」。

### [編纂]用途

我們估計，經扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]佣金及估計[編纂]並計及任何額外酌情激勵費用後，假設[編纂]為每股[編纂]港元（即[編纂]範圍每股[編纂]港元至每股[編纂]港元的中位數），[編纂][編纂]將約為[編纂]港元。

我們擬將[編纂][編纂]用於以下用途：

- 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於透過持續研發與創新推動產品迭代並建立多元化產品組合。我們將迭代升級核心閃存芯片產品線，加強模擬芯片產品開發，並優化產品性能，以滿足邊緣計算場景下的AI計算與信息安全需求，從而擴大產品組合。尤其是：
- 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於擴大我們的代碼型閃存芯片產品的研發活動並推動技術與產品的迭代升級。我們正積極推動基於新一代NORD工藝平台的NOR Flash產品開發，及在20nm工藝節點實現SLC NAND Flash的量產突破。尤其是：
- 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於招聘擁有豐富代碼型閃存芯片經驗的額外研發人員。我們主要計劃招聘(i)IC設計工程師，負責設計及實現片內數位電路以及優化記憶體算法，以提升產品競爭力；(ii)測試工程師，負責測試晶圓與芯片的功能並進行可靠性測試；(iii)驗證工程師，負責在流片前識別功能性設計缺陷；(iv)佈局工程師，負責設計及實現芯片佈局、優化芯片面積及提升芯片可靠性；(v)項目經理及助理，負責領導項目整體研發過程及確保成功執行；

---

## 未來計劃及[編纂]

---

- 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於支持我們的研發活動，從而鞏固並擴大我們的技術優勢及市場份額：(i)採購先進半導體測試與可靠性設備，用於製程驗證及良率優化，例如可靠性老化測試機及三溫測試設備；(ii)採購光罩並進行代碼型閃存芯片的工程流片，以實現IC設計的物理組裝及功能驗證；(iii)採購探針卡用於在CP測試中測試代碼型閃存芯片的功能；(iv)採購電子設備及軟件工具，例如EDA工具及其他軟件授權，以方便日常運作及IC設計；及(v)其他開支，包括項目前置工作開支、項目或有開支及租賃開支。
- 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於擴大我們的CIM AI芯片的研發活動並推動技術與產品的迭代升級。我們將基於新型存儲器ReRAM研發CIM AI芯片，為主控芯片提供功耗更低、效率更高、成本更優的AI算力。尤其是：
- 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於招聘擁有豐富CIM AI芯片經驗的額外研發人員。我們的招聘計劃包括：(i)芯片開發工程師，負責設計芯片的邏輯功能與控制單元，進行電路設計與模擬；(ii)軟件算法系統開發工程師，負責實現算法、設計系統架構及優化性能與效率；(iii)AI應用及適應工程師，負責性能建模與需求回饋、開發及優化軟件棧及透過全棧效能優化管理模型遷移，確保軟件能高效運用芯片的硬件性能；及(iv)項目經理，負責監督項目執行，以確保在符合時間表、預算與品質要求的情況下完成；
- 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於支持我們的研發活動，從而鞏固並擴大我們的技術優勢及市場份額：(i)進行工程流片，以支持IC設計的物理組裝及功能驗證；(ii)購買電子設備及軟件工具，例如EDA工具及

---

## 未來計劃及[編纂]

---

其他軟件授權；(iii)其他開支，包括項目前置工作開支、項目或有開支、租賃開支、競爭對手分析開支及營運開支。

- 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於擴大我們的模擬芯片的研發活動並推動技術與產品的迭代升級，使我們從單一存儲芯片供應商向綜合型通用芯片設計企業升級。尤其是：
  - 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於招聘擁有豐富模擬芯片經驗的額外研發人員。我們的招聘計劃包括：(i)芯片研發工程師，負責透過克服技術困難確保芯片性能；(ii)工程實施工程師，負責將成熟的模擬芯片設計轉化為穩定、可靠及可量產的高質產品，以實現大規模交付；(iii)算法工程師，負責核心性能指標以平衡功能與成本；及(iv)項目經理，負責監督及協調項目的整體執行。
  - 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於(i)採購光罩並進行模擬芯片的工程流片，以實現IC設計的物理組裝及功能驗證；(ii)採購電子設備及軟件工具，例如EDA工具及其他軟件授權；(iii)購買先進設備，用於不同階段的IC設計、除錯、維護及驗證，例如高頻寬示波器；及(iv)我們項目的其他開支，包括項目前置工作開支、項目或有開支及租賃開支。
- 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於提升我們未來五年的營運能力。此分配反映對長期競爭力及支持可持續增長的戰略承諾。尤其是：
  - 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於擴建我們的工程中心，以改善我們的研發能力及提升營運效率，包括(i)預期租期內的場地租金及工程中心設施的裝修；(ii)辦公室及研發的必要設備開支，例如高速自動化測試設備與加速模擬器；(iii)軟硬件基礎設施開支，包括伺服器、存儲

## 未來計劃及[編纂]

系統及EDA工具；及(iv)半導體產品試作及實驗性測試開支。該等投資將擴大設施的面積及功能範圍，使我們能支持更多種類的研究、產品開發及測試能力。

- 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於在未來五年擴大銷售網絡及客戶覆蓋範圍。尤其是，(i)由於我們計劃挽留現有營銷人員，並計劃在中國內地與海外吸引新營銷人員，營銷團隊的薪金將會增加；及(ii)我們計劃產生展覽及廣告開支，以改善我們的品牌推廣；
- 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於加強我們的供應鏈能力，主要用於(i)透過向供應商預付款及支付供應鏈培訓開支，優化我們的供應鏈架構及流程，並發展及優化我們的採購流程；(ii)維持並擴大我們在總部、外包封裝及測試工廠及CP測試工廠的營運團隊，將使整體工資開支隨團隊成員增加而上升。
- 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於未來五年的戰略投資及收購。該等資金將用於在中國內地與海外選擇性地尋求戰略及行業相關合作、投資及收購，針對可輔助並加強現有產品組合的技術及公司。在我們的「AI+」與「存儲+」雙輪驅動戰略下，我們將積極挖掘產業鏈相關的潛在併購和投資標的。我們重點聚焦與現有產品組合、核心技術及目標市場具有顯著協同價值的領域，旨在通過戰略性整合行業優質資源，完善產品矩陣佈局，拓展高附加值下游應用市場。請參閱「業務 — 發展戰略 — 五、尋求產業鏈相關的併購和投資機遇，實現外延增長」。

截至最後實際可行日期，我們尚未發現任何具體收購或投資標的。任何潛在機會均會經審慎評估，並在考慮市況、技術契合度及潛在投資回報後有序推進。

---

## 未來計劃及[編纂]

---

- 約[編纂]%，或[編纂]港元，將用於營運資金及一般公司用途。

倘[編纂]定為指示性[編纂]的最高[編纂]或最低[編纂]，[編纂][編纂]將分別增加或減少約[編纂]港元。

倘[編纂]獲悉數行使，我們將收取的額外[編纂]為(i) [編纂]港元(假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即最低[編纂])；(ii) [編纂]港元(假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即[編纂]中位數)；及(iii) [編纂]港元(假設[編纂]為每股H股[編纂]港元，即最高[編纂])。

倘[編纂][編纂](包括來自行使[編纂]的[編纂])高於或低於預期，我們可按比例調整用於上述用途的[編纂]分配。

倘[編纂][編纂]並未立即用於上述用途，或我們無法如期執行未來發展計劃的任何部分，在認為符合本公司最佳利益的情況下，我們可將該等資金存放於持牌商業銀行及／或其他認可財務機構(定義見證券及期貨條例或其他司法管轄區的適用法律法規)的短期計息賬戶。在此情況下，我們將遵守上市規則項下的適當披露規定。